

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMP とその応用技術専門委員会
第234回研究会開催のご案内

このたび、プラナリゼーションCMP 専門委員会では、下記の通り第234回『半導体の戦略資源化、これを実現するCMP 関連の材料・装置の展開』研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。是非ご参加下さい。



日 時：2026年10月14日（水）13:00～17:15/17:20～19:20 情報交換会

開催場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 東京駅大手町（大手町駅 A5・B2A 出口直結）

東京都千代田区大手町2丁目1-1 大成大手町ビル 17階 TEL03-6262-2561

※オンサイトのみの開催となります。

※開催10営業日前の9月29日午前中までに必ず事前登録をお願い致します。

プログラム：

1. 13:00 ～ 13:05 開会挨拶
2. 13:10 ～ 16:25 第一部 講演／質疑応答含む

1) 13:10～13:50 (40分)

「先端ロジックデバイスの技術動向」

東京エレクトロン㈱ 大藤 徹 氏

＜概要＞ 本講演では、AI/HPC 向けシステムの性能向上にはトランジスタ数の拡大とメモリ帯域の向上が不可欠との観点から、これらを実現するための技術を紹介する。まず、トランジスタ微細化を中心としたスケーリングの進展と今後の方向性を概観する。さらに、トランジスタ密度向上のためには非論理領域の削減によるチップ利用率向上も重要であることを述べ、その具体例としてBEOL デバイス、高密度 MIM キャパシタ、裏面配線技術を解説する。また、高メモリ帯域接続を実現する重要技術として、各種ボンディング技術について紹介する。

2) 13:50～14:30 (40分)

「CMP 技術のスケール横断 ―微細からパッケージまで支える二刀流アプローチ―」

㈱荏原製作所 野村 季和 氏

＜概要＞ 半導体デバイスの微細化は継続して進んでおり、それに対する高度な要求に対しての挑戦は続いている。一方 AI の普及に伴い、積層技術も進歩しており、CMP としても新しいフィールドでの挑戦が始まった。大きく異なる二つのフィールドでの CMP 装置のあり方を考える。

.....
14:30～14:45 休憩
.....

3) 14:45～15:15 (30分)

「光を用いたCMP スラリーの分析・計測技術 - 粒度分布から化学組成分析」

㈱堀場製作所 石原颯一郎 氏

＜概要＞ CMP スラリーの生産工程やCMP プロセス中において、スラリー中の粒子径やスラリー溶液組成の管理、測定などが求められている。本講演では、HORIBA が有する粒度分布測定技術および分光技術による組成分析について紹介する。

4) 15:15～15:45 (30分)

「金属イオンキレート能を有する官能基を粒子表面に導入したコロイダルシリカ」

扶桑化学工業㈱ 中野 智陽 氏

＜概要＞ 半導体デバイス製造では金属配線材料を CMP で平坦化するプロセスが多用される。製造スループット向上のため、CMP における金属材料の研磨速度向上が求められている。金属の研磨速度向上を目的とし、金属イオンキレート能を有する官能基を粒子表面に導入したコロイダルシリカを作製した。当該コロイダルシリカの性状と研磨試験結果を報告する。

5) 15:45～16:25 (40 分)

「日本の半導体政策の今後について」

経済産業省 五味 信之 氏

＜概要＞ AI と半導体が国家の競争力、社会基盤の安定、経済安全保障を左右する基盤となりつつある構造的な変化を整理し、バーティカル AI とフィジカル AI への進展という技術潮流を示す。その上で、我が国が有する現場データという強みを新たな競争力へと変換することの重要性を示し、System to Silicon の実現に向けた戦略について説明する。

3. 16:40 ～ 17:15 (35 分) 第二部 パネルディスカッション

パネラー：五味 信之様（経済産業省）、山田 洋平様（Rapidus 株式会社）、
大藤 徹様（東京エレクトロン株式会社）、近藤 誠一様（株式会社レゾナック）

＜概要＞ 10 月度研究会のテーマでもある「半導体の戦略資源化、これを実現する CMP 関連の材料・装置の展開」について、①半導体戦略資源化、②先端デバイス側の要求、③異分野の共創 の3つの観点より、各界を代表するリーダーの方々に熱く語って頂く。

4. 17:15～17:20 連絡事項

閉会挨拶

5. 17:20～19:20 情報交換会

参加費

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円） ※2 名迄無料、3 名以上は 3,000 円／1 名
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）
※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

2026 年 10 月 14 日 (水) 第 234 回研究会参加申込書

☐ 第 234 回研究会 ☐ 情報交換会

氏 名				
勤務先・所属				
連絡先	住所			
	TEL		FAX	
	E-mail			

※ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーション CMP 専門委員会」事務局（喜多見）

TEL：03-5962-3145, FAX：03-5962-3146, e-mail：kitami@global-net.co.jp